



技术数据表 (TDS)

EMG-200

特点 EOCN树脂, 熔融硅+结晶硅, 适用于D0(3/6A), SMA, 桥, T092/126/220, DIP等器件的封装。

典型指标

测试项目	单位	典型值
颜色	-	黑色
胶化时间(175°C)	s	19
流动长度(175°C)	cm	80
填料含量	%	77
阻燃剂类型	-	MOH
Tg	°C	165
线膨胀系数 α 1	$\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	22
线膨胀系数 α 2	$\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	65
密度	g/cm^3	1.98
成型收缩率	%	0.35
弯曲强度	Mpa	137
弯曲模量	Mpa	22000
导热系数	W/(MK)	1.18
阻燃性@1/4"	-	V-0
吸水率(85°C, 85%, 168H)	%	0.35
体积电阻率	$\times 10^{15} \Omega\text{cm}$	19
电导率	$\mu\text{s}/\text{cm}$	9.6
pH	-	7
氯离子含量	ppm	<10
钠离子含量	ppm	<5

成型/后固化条件

	单位	范围
成型温度	°C	160-180
注塑压力	kgf/cm^2	30-60
后固化温度	°C	160-180
后固化时间	H	4-8

储存条件/有效期 5°C以下密封保存6个月

典型数据, 仅供参考

江苏华海诚科新材料有限公司
Jiangsu HHCK Advanced Materials Co., Ltd.